

Spezifikation Leiterplattenfertigung

Allgemeines

Fertigung nach IPC Klasse 1 (IPC 60xx)	Ja
Fertigung nach IPC Klasse 2 (IPC 60xx)	Ja
Fertigung nach IPC Klasse 3 (IPC 60xx)	Ja

Bearbeitung Mechanik

Konturbearbeitung	+/- 0.10 mm
Niveau-Fräsung	+/- 0.08 mm
Bohrdurchmesser dk	+/- 0.08 mm
Bohrdurchmesser ndk	+/- 0.05 mm
Passbohrungen	+/- 0.05 mm
Versatz Bohrung-Bohrung	+/- 0.05 mm
Versatz Leiterbild-Bohrbild	+/- 0.10 mm
Leiterbild zueinander	+/- 0.05 mm
Tiefe Senkloch	+/- 0.05 mm
max. Dicke ML	5,5mm
min. Drill @ 3,2mm Materialdicke	0,5mm
min. Drill @ 2,4mm Materialdicke	0,4mm
min. Drill @ 1,6mm Materialdicke	0,3mm
min. Drill @ 0,8mm Materialdicke	0,2mm
Laser Bohrung	Ja

Bearbeitung Galvanik

max Kupferdicke auf allen Lagen	105µm (210/400/500µm)
min. Leiterbahnbreite@35µm Kupfer	100µm
min. Leiterbahnbreite@70µm Kupfer	200µm
min. Leiterbahnbreite@105µm Kupfer	200µm
min. Leiterbahnabstand@35µm Kupfer	100µm
min. Leiterbahnabstand@70µm Kupfer	200µm
min. Leiterbahnabstand@105µm Kupfer	200µm
Restring@35µm Kupfer	100µm
Restring@70µm Kupfer	150µm
Restring@105µm Kupfer	150µm

Lager Material

FR4	Ja
FR4 HochTg/150/170°C/ teilweise halogenfrei	Ja
RO4003 / RO4350	Ja
Polyimid Kapton 25µm/50µm/Kleber	Ja
Polyimid (Arlon 35N), TG ≥ 250°C	Ja
IMS Material (Aluminium 1,5mm einseitig beschichtet)	Ja

Oberflächen

HAL	Ja
chem. Zinn	Ja
chem. Silber	Ja
chem. Nickel Gold	Ja
gal. Hartgold min. 3µNi/1µAu	Ja
gal. Hartgold min. 6µNi/2µAu	Ja
Gal. Bondgold 3-5µm Ni/ 1-2µm Au	Ja

Prüfung

optische Kontrolle (AOI/Manuell)	AOI alle Lagen
optische Ausgangskontrolle	Ja
Kurzschlussmessung > 10MOhm	Ja
Durchgangsmessung < 10Ohm	Ja